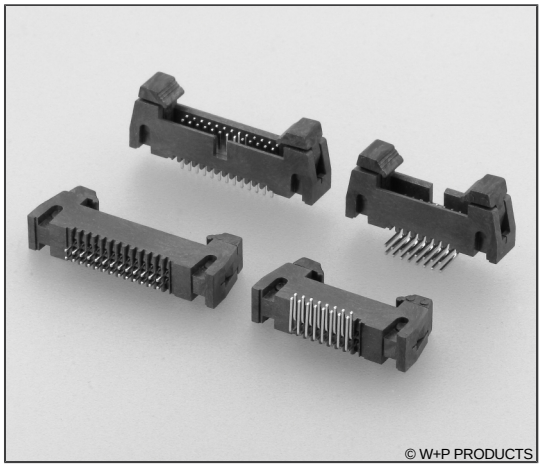
337

Wannenstiftleisten mit Verriegelung RM 1,27mm, gerade/gewinkelt

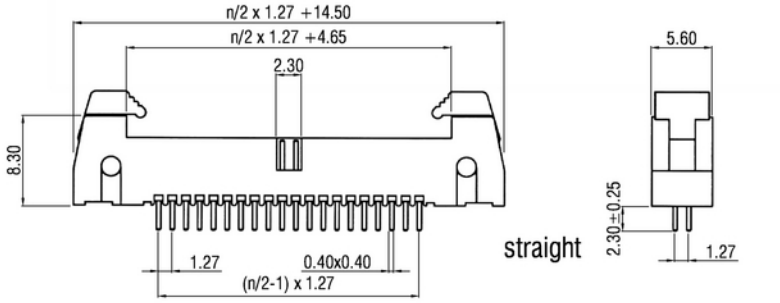
Box Headers with Latches, 1.27mm Pitch, Straight/Right-Angled

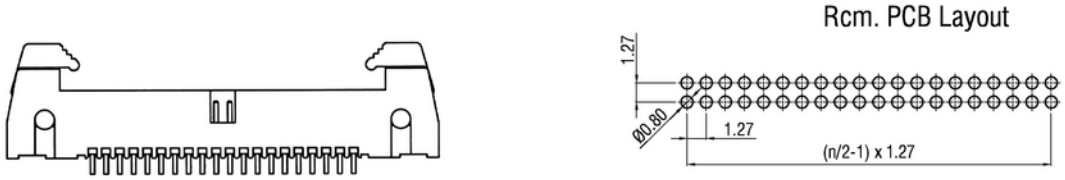
Technische Daten / ***Technical Data***

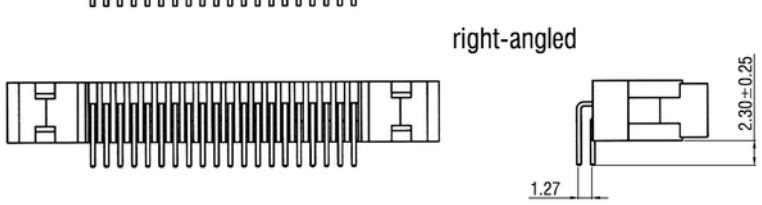
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	*IEC 60512-12A*
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	*< 20mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	*> 1000MΩ*
Spannungsfestigkeit	$300V_{AC}$
Test Voltage	*$300V_{AC}$*
Nennstrom	1A
Current Rating	*1A*
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	*-40°C ... +105°C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Passende Gegenstecker:
Mates with Connectors:
376







Series	***Contacts****	***Type****	***Plating****
337	**12**	**1**	**00**
	06 10 12 14 16 **20 26 30 34 40** **44 50 60 68 80**	**1** Gerade *Straight* **2** Gewinkelt *Right-angled*	**00** Vergoldet *Gold plated*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung
Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150°C
Temperatur Maximum $T_S$max	200°C
Dauer $T_S$min - $T_S$max	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_S$max - T_P	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_P$max - $T_S$min	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150°C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200°C*
Duration $T_S$min - $T_S$max	*60-180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217°C*
Duration above T_L	*60-180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max - T_P	*max. 3°C / s*
Peak Temperature T_P	*260°C ±5*
Duration Peak Temperature	*20-40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max - $T_S$min	*6°C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*Max. 8min*